

**NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD**

**CEI  
IEC**

**61191-3**

Première édition  
First edition  
1998-08

---

---

**Ensembles de cartes imprimées –**

**Partie 3:  
Spécification intermédiaire –  
Exigences relatives à l'assemblage par brasage  
de trous traversants**

**Printed board assemblies –**

**Part 3:  
Sectional specification –  
Requirements for through-hole mount  
soldered assemblies**

© IEC 1998 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission  
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: [inmail@iec.ch](mailto:inmail@iec.ch)

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland  
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

**P**

*Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue*

## SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS .....	4
Articles	
1 Généralités .....	6
1.1 Domaine d'application .....	6
1.2 Classification .....	6
2 Références normatives.....	6
3 Technologie de montage à trous traversants.....	8
4 Montage de composants par trous traversants.....	8
4.1 Précision du placement.....	8
4.2 Exigences relatives aux composants à trous traversants.....	8
5 Exigences d'acceptation.....	14
5.1 Contrôle et actions correctives .....	14
5.2 Brasage des sorties de composants à trous traversants.....	16
6 Retouche de connexions brasées non satisfaisantes .....	20
Annexe A (normative) Exigences de placement pour les dispositifs de montage par trous traversants.....	22

## CONTENTS

	Page
FOREWORD .....	5
Clause	
1 General.....	7
1.1 Scope .....	7
1.2 Classification .....	7
2 Normative references .....	7
3 Through-hole technology (THT) .....	9
4 Through-hole mounting of components .....	9
4.1 Placement accuracy .....	9
4.2 Through-hole component requirements .....	9
5 Acceptance requirements .....	15
5.1 Control and corrective actions .....	15
5.2 Through-hole component lead soldering .....	17
6 Rework of unsatisfactory solder connections .....	21
Annex A (normative) Placement requirements for through-hole mount devices .....	23

WITHDRAWN

## COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

## ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMÉES –

**Partie 3: Spécification intermédiaire –  
Exigences relatives à l'assemblage par brasage  
de trous traversants**

## AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 61191-3 a été établie par le comité d'études 91 de la CEI: Technique du montage en surface.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
91/133/FDIS	91/144/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

La CEI 61191 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: *Ensembles de cartes imprimées*:

*Partie 1: Spécification générique – Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées*

*Partie 2: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage par brasage pour montage en surface*

*Partie 3: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage par brasage de trous traversants*

*Partie 4: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage de bornes par brasage*

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 61191-1.

## INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

### **PRINTED BOARD ASSEMBLIES – Part 3: Sectional specification – Requirements for through-hole mount soldered assemblies**

#### FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61191-3 has been prepared by IEC technical committee 91: Surface mounting technology.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on Voting
91/133/FDIS	91/144/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

IEC 61191 consists of the following parts, under the general title: *Printed board assemblies*:

*Part 1: Generic specification – Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies*

*Part 2: Sectional specification – Requirements for surface mount soldered assemblies*

*Part 3: Sectional specification – Requirements for through-hole mount soldered assemblies*

*Part 4: Sectional specification – Requirements for terminal soldered assemblies*

Annex A forms an integral part of this standard.

This standard is to be read in conjunction with IEC 61191-1.

## ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMÉES –

### Partie 3: Spécification intermédiaire – Exigences relatives à l'assemblage par brasage de trous traversants

#### 1 Généralités

##### 1.1 Domaine d'application

Cette spécification décrit les exigences relatives aux ensembles de composants à trous traversants (broches et trous) montés par brasage. Les exigences s'appliquent aux ensembles entièrement constitués d'après une technique de montage par trous traversants (THT) et aux portions THT d'ensembles incluant d'autres techniques associées (par exemple montage en surface, montage à puce, montage à borne).

##### 1.2 Classification

La présente spécification reconnaît que les ensembles électriques et électroniques sont soumis à des classifications correspondant à l'utilisation finale prévue pour l'article. Trois classes générales relatives au produit fini ont été établies afin de refléter les différences au niveau de la productibilité, de la complexité, des exigences de performances fonctionnelles et de la fréquence des vérifications (contrôle/essai). Il s'agit de ce qui suit:

- Niveau A: Produits électroniques généraux
- Niveau B: Produits électroniques spécialisés
- Niveau C: Produits électroniques à hautes performances

C'est à l'utilisateur des ensembles que revient la responsabilité de déterminer le niveau auquel le produit appartient. Il convient d'admettre d'éventuels empiètements de matériels entre différents niveaux. Le contrat doit spécifier le niveau prescrit et indiquer toute exception ou exigence supplémentaire concernant les paramètres, le cas échéant.

#### 2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 61191. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 61191 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61191-1:1998, *Ensembles de cartes imprimées – Partie 1: Spécification générique – Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées*

## PRINTED BOARD ASSEMBLIES –

### Part 3: Sectional specification – Requirements for through-hole mount soldered assemblies

## 1 General

### 1.1 Scope

This standard prescribes requirements for lead and hole solder assembly. The requirements pertain to those assemblies that are totally lead and hole, through-hole mounting technology (THT), or the THT portions of those assemblies that include other related technologies (i.e. surface mount, chip mounting, terminal mounting).

### 1.2 Classification

This specification recognizes that electrical and electronic assemblies are subject to classifications by intended end-item use. Three general end-product classes have been established to reflect differences in producibility, complexity, functional performance requirements, and verification (inspection/test) frequency. These are the following:

Level A: General electronic products

Level B: Dedicated service electronic products

Level C: High performance electronic products

The user of the assemblies is responsible for determining the level to which his product belongs. It should be recognized that there may be overlaps of equipment between levels. The contract must specify the level required and indicate any exceptions or additional requirements to the parameters, where appropriate.

## 2 Normative references

The following normative document contains provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 61191. At the time of publication, the edition indicated was valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 61191 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the normative document indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 61191-1:1998, *Printed board assemblies – Part 1: Generic specification – Requirements for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly technologies*